

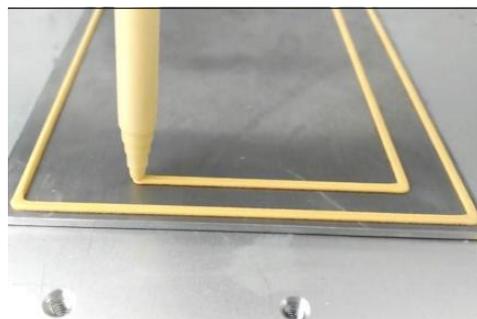
# KLEBER KB-XERM SG2060D 导热有机硅填缝剂

## 产品介绍

KLEBER KB-XERM SG2060D是一种双组分导热有机硅填缝剂，可以为电力电子等器件提供良好的导热性。

## 性能及特点

- 常温或加热固化
- 低固化放热及固化应力
- 良好的导热
- 耐高温
- 阻燃



## 技术参数

性能	单位	A组分	B组分	混合后
外观	-	黄色	白色	浅黄色
粘度 @ 25°C	Pa·s	85	90	85
相对密度	-	2.0	2.0	2.0
体积混合比	-	1	1	-
重量混合比	-	1	1	-
操作时间 @ 25°C	min	-	-	60
固化时间 @ 25°C	h	-	-	12
固化时间 @ 120°C	min	-	-	30

## 固化后性能

性能	单位	测试标准	数值
导热率	W/m·K	ASTM D5470	2.0
硬度	Shore OO	ASTM D2240	65
拉伸强度	MPa	ASTM D638	0.17
断裂伸长率	%	ASTM D638	20
体积电阻率 @ 25°C	Ohm-cm	ASTM D257	1x10 <sup>13</sup>
介电强度	kV/mm	ASTM D149	13

## 典型应用

- 车载充电器
- 电力电子
- 汽车
- 通讯电子

## 操作工艺

- 混合及应用：两个组分按体积比或重量比1:1充分混合直至颜色均一，在大量使用时建议使用自动混合点胶设备，混合过程中建议使用真空设备来减少气泡的进入。
- 固化：混合后的胶可以在120°C下30分钟固化，或者常温12小时固化。避免在粘结基材上留有影响反应的杂质：如胺，硫醇及锡盐等。

## 储存条件

- 每个组分自生产之日起，储存在未开封的原装容器内，且温度为10°C至25°C条件下，保质期为6个月。胶水的包装容器可定期倒置以减轻沉降产生。

## 声明

本技术数据表 (TDS) 中提供的信息 (包括产品使用和应用建议) 基于我们对科蓝柏产品的了解和经验。此TDS包含的数据仅供参考，并不被认为是可靠的。我们不能对他人因我们无法控制的方法而获得的结果承担责任。该产品在您的环境中可以有各种不同的应用以及不同的工作条件，这是我们无法控制的。因此，科蓝柏公司对产品是否适合您使用它们的生产过程和条件以及预期的应用和结果不承担任何责任。我们强烈建议您在产品使用前事先进行试验以确认产品的适用性。